



RE900-05

- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Zweiseitig 35 µm Cu
- Durchkontaktiert (PTH)
- Oberfläche chem. Ni/Au mit Lötstopplack beschichtet
- Adaptionplatine für TSOP II 40, 44 (0,80 mm)
- Lochdurchmesser 1,00 mm
- Gerberdaten zur Herstellung des Lötpastenaufdrucks werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt
- Größe 29,29 x 30,94 mm

Modul-Nr.	Typ	Pitch	Pin	Größe (mm)
RE900-05	TSOP II	0,800 mm	40, 44	11,50 x 18,80